

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

## 浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-12-001

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称及人员姓名	国信证券 胡剑、胡慧； 中信建投 徐博； 万家基金 陈飞达； 交银施罗德 余李平、杨茉然； 南方基金 陈思臻； 大成基金 李磊； 招商基金 高岩； 浦银安盛 杨达伟、赵楠、郑敏宏、朱胜波； 淳厚基金 吴若宗、陈文； 中科沃土 黄艺明； 恒生前海 李峥嵘； 恒越基金 赵炯； 海富通基金 刘海啸； 东吴基金 江耀堃； 长盛基金 乔培涛； 中金基金 汪洋；

	<p>金元顺安基金 张博；</p> <p>易方达基金 王元春；</p> <p>上投摩根基金 黄进；</p> <p>信达澳银 李淑彦、齐兴方、朱然、童昌希、张凯；</p> <p>北京遵道资产管理有限公司 杨增飞；</p> <p>上海龙全投资管理有限公司 邢增岛；</p> <p>深圳瑞业资产管理有限公司 丁小兆；</p> <p>Power Pacific 周俊恺；</p> <p>上海涌贝资产管理有限公司 马涌超；</p> <p>光大资管 李行杰；</p> <p>广州市航长投资管理有限公司 麦浩明；</p> <p>禹合资产管理（杭州）有限公司 丁凌霄；</p> <p>深圳诚诺资产管理有限公司 黄敏；</p> <p>平安养老保险股份有限公司 李志磊；</p> <p>上海晨燕资产管理中心（有限合伙） 詹凌燕；</p> <p>北京源乐晟资产管理有限公司 杨建海、浦东君、董昊。</p>
时间	2021 年 12 月 16 日
地点	公司会议室（电话会议）
上市公司接待人姓名	副总经理/董事会秘书 李志萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>浙江中晶科技股份有限公司（股票代码：中晶科技 003026.SZ）是一家专业从事半导体单晶硅材料及其制品研发、生产和销售的国家高新技术企业，是全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位，公司拥有宁夏中晶、西安中晶、</p>

中晶新材料全资子公司及江苏皋鑫控股子公司。

公司拥有先进的具备自主知识产权的核心技术和工艺，配备优良的生产、检测设备和管理系统，以国际一流半导体企业为标准，致力于高品质半导体单晶硅材料及其制品的研发和生产。公司在半导体用单晶硅棒、研磨硅片、高压整流器件三个细分产业具有市场领先地位，形成以研磨硅片、抛光硅片、芯片元件为核心业务的三大产业板块，积极成为世界先进的半导体硅材料专业制造商而努力奋斗。

## 二、互动交流

### 1、公司募投项目的进展如何？项目推进中存在哪些困难？

公司募投项目按照整体规划加速推进中，暂不存在影响募投项目进度的重大障碍。

### 2、请问公司经营是否受到疫情影响？

公司一直密切关注新冠疫情变化，积极支持政府的防疫政策，并对进入厂区的所有人员采取了谨慎严格的防疫措施，目前公司生产经营情况正常。

### 3、公司目前主营业务经营情况如何？

公司当前主营业务的经营布局如下：晶棒端以宁夏中晶为主要生产基地；硅研磨片以浙江中晶与西安中晶为核心，该业务在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位；募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》以中晶新材料为实施主体，当前正在加速推进中；公司收购设立江苏皋鑫，积极推动实施《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》。公司未来继续深耕半导体硅材料领域，不断提高公司主营业务的发展实力及产品影响力，提升公司经营业绩。

### 4、公司未来还有投资收购的计划吗？

	<p>公司未来将会在巩固现有行业地位的前提下，根据行业发展趋势和客户需求，密切关注与半导体材料行业相关的合作契机，进一步完善半导体硅材料产品结构，提升公司创新能力和核心竞争力，促进公司的进一步发展。</p> <p><b>5、公司接下来是否有股权激励及融资计划的安排？</b></p> <p>公司一直致力于多渠道多形式来激励员工，以形成合力推动公司战略目标和经营目标的实现，吸引和留住优秀人才，公司会根据实际情况适时推出股权激励计划。根据公司未来的发展规划、资金情况等因素来综合考虑融资安排。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 12 月 16 日